



Solder plus Support

SN100C®

ALEACIÓN DE SOLDADURA

Disponible en Pasta, Alambre, Barra y Preformas



SN100C ALEACIÓN UN VISTAZO A LA

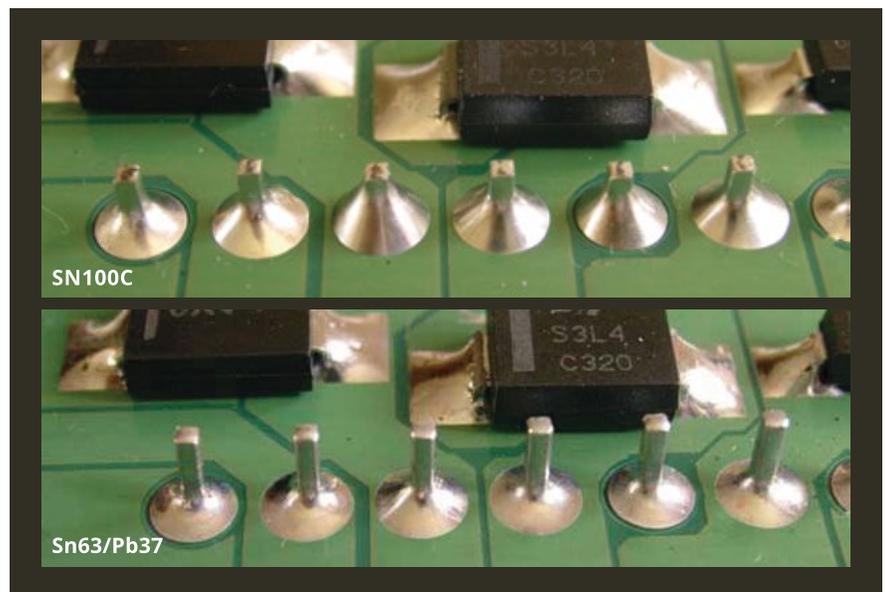
- ▶ Ahorro significativo en costos, no contiene los costosos plata o bismuto
- ▶ Aleación Eutéctica
- ▶ Soldadura por ola Libre de Cortos y de Residuos
- ▶ Uniones de soldadura, brillantes y bien formadas
- ▶ Generación de escoria igual o menor que la soldadura estaño-plomo
- ▶ Menor índice de oxidación en perforaciones, tablillas y tramos que otras aleaciones libres de plomo



AIM, líder mundial en la fabricación de materiales de soldadura para la industria electrónica, ofrece la SN100C, la aleación libre de plomo y libre de plata preferida en la actualidad, con el costo más bajo comparado con cualquier otra aleación de soldadura libre de plomo.

La **SN100C** es una aleación libre de plomo desarrollada por Nihon Superior en Japón, que consta de estaño, cobre y una pequeña cantidad de níquel + germanio. La SN100C ofrece propiedades amigables para el usuario, lo que ha sido comprobado en la producción comercial desde 1999.

La SN100C supera de manera consistente a la SAC305 y a otras aleaciones con plata en varias áreas clave en operaciones de soldadura por ola, selectiva, SMT y manual. Una mejor estética lleva a índices de aceptación mayores, menos objeciones del operador y mejor calidad. Una aleación para todos sus requerimientos de soldadura significa menos inquietudes en la compatibilidad de las aleaciones y en menores costos generales.



COMPARACIÓN DE SUPERFICIE DE LA SOLDADURA SN100C®

ENFRIAMIENTO
RÁPIDO



ENFRIAMIENTO
LENTO



SN100C

SAC305

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MELTING POINT	ALLOY DENSITY	COMPOSITION (mass%)			
		Sn	Cu	Ni	Ge
227°C	0.2634 lb/in ³	R	0.7	0.05	≤0.01

SEAMLESS CHANGEOVER The issue of lead-free soldering can be complex. We invite you to benefit from our expertise in material selection and process development in lead-free soldering implementation. AIM's services include process audits, solder pot analyses and applications support. AIM is here to help you from changeover right through optimization.

ALLOY COMPATIBILITY Extensive testing has demonstrated that no degradation occurs when mixing SN100C with tin-silver-copper or other lead-free alloys. Therefore, it is acceptable to utilize SN100C for wave soldering and SAC305 for SMT without compromising reliability. No reliability degradation is found when using SN100C wire to touch up SAC305 solder joints and vice versa. Please contact AIM or visit <http://www.aimsolder.com/products/sn100c> for a full report.

WORLDWIDE AVAILABILITY SN100C is available from AIM in solder paste, bar, cored and solid wire, solder performs and solder spheres.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ADICIONALES DE LA SN100C

- Resistencia a la fatiga térmica y fuerza en el plaqueado superior al de estaño-plomo
- Buena presentación en perforaciones
- Buena formación de filetes en la parte superior
- Ofrece un alto rendimiento
- No requiere una atmósfera de nitrógeno
- Bajo índice de filtración de cobre que facilita controlar el contenido de cobre del baño de soldadura
- Menor agresividad hacia el acero inoxidable y a otros materiales del tarro de soldadura, en comparación a las aleaciones estaño-plata-cobre
- Crecimiento parejo y lento de la capa intermetálica en la interfase soldadura-substrato

ALLOY COMPATIBILITY TEST DATA BEFORE AND AFTER THERMAL CYCLING

Results show that solder joints made with SAC, SN100C and the SN100C plus SAC mixture are all comparable to tin-lead solder joints made on the same board. Extensive thermal cycle testing exhibits no measurable degradation of mixed alloy solder joints.

ALLOY	0 CYCLES	1000 CYCLES
SAC305	15.3 lbs	15.0 lbs
SN100C / SAC mix	14.1 lbs	14.3 lbs
SN100C	14.2 lbs	14.0 lbs
Sn/Pb	14.8 lbs	14.5 lbs